

放熱材料

放熱シリコン／放熱ゴム(ゲル)成形品／放熱樹脂成形品／放熱コーティング剤

電子デバイスの
放熱対策をサポートします。

電子デバイスが発生する熱を効率よく取り除く、
さまざまな放熱対策ソリューションをご提供。

高機能デバイスのサーマル・インターフェースから基板
のアセンブリ、部品のポッティング、コーティングま
で、多岐に渡ったアプリケーションの熱対策ニーズに適
合する製品ラインナップを提供しています。

- 卓越した熱伝導性、塗膜性、物理・化学的安定性。
- 電子デバイスが発生する熱を効率よく取り除き、電子
部品の効率と信頼性を長期的に向上します。
- 放熱を必要とする従来型汎用デバイス用にも利用可能
な放熱材料も取り揃えています。

放熱
シリコン
シリーズ

放熱
ゴム(ゲル)
成形品
シリーズ

熱対策

放熱
樹脂成形品

放熱
コーティング剤

熱対策のことなら光アルファクス。

放熱グリース

- 自動シリジ塗布、スクリーン印刷が可能です。
- 熱伝導率 2~4W/m・K



放熱接着剤

- 室温硬化タイプ、加熱速硬化タイプがあります。
- 熱伝導率 1.7~6.0W/m・K



放熱ポッティング材・封止材

- 低粘度、低硬度、低温硬化タイプです。
- 熱伝導率 0.63~3.0W/m・K



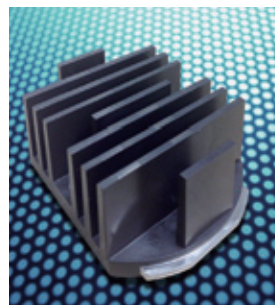
放熱ゴム(ゲル)成形品シリーズ

- 高硬度シリコン放熱ゴム。(熱伝導率 1~5 W/m・K)
(シート、キャップ、チューブなど各種形状)
- 低硬度シリコン放熱ゴム。(アスカーC 20~45)
- 超低硬度シリコン放熱ゴム。(アスカーC 2~4)
- 熱伝導性両面粘着シリコンテープ。
(厚み100ミクロン・200ミクロン)
- 電磁波ノイズ抑制・熱伝導シリコンゴムシート。
- 低分子シロキサンフリーの非シリコン系ゴムシート。



放熱樹脂成形品

- 樹脂最高レベルの放熱性。
(熱伝導率 ~2.9 W/m・K)
- 精密射出成形用材料。
(形状自由度UP、軽量化)
- 難燃グレードもラインアップ。
- 放熱シュミレーションのご提案。
- 放熱システム・デザインのご提案。

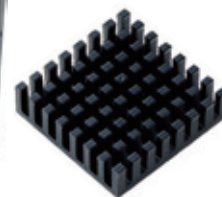


放熱コーティング剤

- 放射熱(電磁波)への変換による冷却効果。
- 各種金属・プラスチックへの塗布が可能。
(ヒートシンク、筐体など)
- 白色基調、着色も可能。透明タイプも品揃え。

■主な用途例

- 電子デバイス、電源基板部品、バッテリーの放熱。
- 車載パワーモジュール、FPDドライバーICの放熱。
- LED照明機器、PC、ゲーム機の放熱。



上記の製品以外にも熱対策ニーズに適合する製品ラインナップを提供しています。

サンプル・技術資料のご用命など、お気軽にお問い合わせ下さい。

販売元



www.hikari-ax.co.jp

マテリアル営業本部 お近くの担当部署までご連絡ください。

- 大阪本社 / 西日本マテリアル営業部 TEL.06-6203-3432
- 東京支社 / 営業推進グループ TEL.03-5418-1224
- 中部支店 / 東日本マテリアル営業部 TEL.052-269-0036



取扱いメーカー

- モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
- 株式会社フコク
- スターライト工業株式会社
- 株式会社イノアックコーポレーション
- 信越化学工業株式会社

本社：〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-2 (大阪中之島ビル)

拠点：国内拠点 / 東京・熊谷・静岡・名古屋・大阪・神戸・京都・広島・北九州
海外拠点 / 香港・上海・バンコク(タイ)・台北(台湾)

● 本資料に掲載されている製品名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。
● 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その仕様の際に当社および第三者の知的財産権その他権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
● 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。